附件4

服务商“小快轻准”型产品汇总表

服务商名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务商名称** | **产品**  **名称** | **产品简介**  **（150字内）** | **交付部署周期**  **（周）** | **产品**  **价格**  **（万元）** | **应用场景** | **适用**  **行业** | **问题及需求分析**  **（150字内）** | **联系人及电话** | **备注** |
| 示例 | ××× | ××× | 基于统一数据模型，构建一体化协同研制平台，以3D为核心的全数字化创新解决方案 | 4-32 | ＜5万 | 生产制造**（参照附件2《三大试点行业应用场景需求清单》填写）** | 智能机器人/半导体及集成电路/精密仪器设备 | 打通数据信息孤岛，以BOM为核心，模型为表达，贯通数字全链路，实现研发设计业务与运营管理的闭环管控**（含行业共性需求与企业个性需求）。** | ×××/13××× |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |